

制程能力表

序号	工序	项目	能力水平	特殊
01	/	层数	2~20层	20~50层
02	/	完成板尺寸 (最大)	510mm×600mm	520mm×914mm
03	/	板厚度 (最大)	3.2mm	6.4mm
04	/	板厚度 (最小)	0.4mm	0.2mm
05	/	成品厚度公差 ($T \geq 1.0$.mm)	$\pm 10\%$	$\pm 7\%$
06	/	成品厚度公差 ($T < 1.0$.mm)	± 0.10 mm	± 0.07 mm
07	/	板曲 (最大)	0.75%	0.50%
08	阻抗	阻抗公差 (最小)	$\pm 10\%$	$\pm 7\%$
09	钻孔	机械钻孔孔径 (最大)	6.35mm	6.4-10mm
10		机械钻孔孔径 (最小)	0.25mm	0.15mm
11		钻孔孔壁最小间距	0.15mm	0.10mm
12		孔径公差 (镀铜通孔)	± 0.076 mm	± 0.05 mm
13		孔径公差 (非镀铜通孔)	± 0.05 mm	+0.05/-0mm
14		孔位公差 (与钻孔资料数相比)	± 0.076 mm	± 0.050 mm
15	电镀	外层底铜厚度 (最小)	1/3 oz	/
16		外层底铜厚度 (最大)	4 oz	6 oz
17		孔电镀纵横比 (最大)	6:1	10:1
18		孔铜厚度	$\geq 25\mu\text{m}$	$\geq 30\mu\text{m}$
19	线路	外层设计线宽/间距 (最小)	T/T oz 3.0mil/3.0mil	T/T oz 2.0mil/2.0mil
20			H/H oz 4.0mil/4.0mil	H/H oz 3.0mil/3.0mil
21			1/1 oz 5.0mil/5.0mil	1/1 oz 4.0mil/4.0mil
22			2/2 oz 6.0mil/7.0mil	2/2 oz 5.0mil/6.0mil
23			3/3 oz 7.0mil/8.0mil	3/3 oz 6.0mil/7.0mil
24		蚀刻公差	$\pm 20\%$	$\pm 10\%$
25	防焊	图形精度 (最小)	± 0.075 mm	± 0.05 mm
26		阻焊对位精度公差	± 0.075 mm	± 0.05 mm
27		阻焊桥宽 (最小)	0.10mm	0.075mm
28	文字	阻焊塞孔孔径 (最大)	0.50mm	0.65mm
29		字符宽度 (最小)	0.12mm	0.10mm
30		字符对位精度公差	± 0.15 mm	± 0.13 mm
31	喷锡	锡厚 (热风整平)	2-20um	2-10um
32	成型	锣外形公差 (边到边) 最大	± 0.15 mm	± 0.10 mm
33		锣外形公差 (孔到边) 最大	± 0.15 mm	± 0.10 mm
34	V-cut	残厚公差 (最小)	± 0.075 mm	± 0.05 mm
35		V槽错位度 (最小)	± 0.10 mm	± 0.075 mm
36		V-槽对V-槽位置公差 (最小)	± 0.10 mm	± 0.075 mm
37		V-槽加工板尺寸 (最大)	400mm	600mm
38		V-槽加工板尺寸 (最小)	75mm	30mm